

放熱効果が高い水平な実装へ、高放熱をサポート

Supports high thermal radiation for horizontal mounting with high thermal radiation effects

ECO SOLDER® PREFORM

HQ ～Niボール応用ソルダプリフォーム～

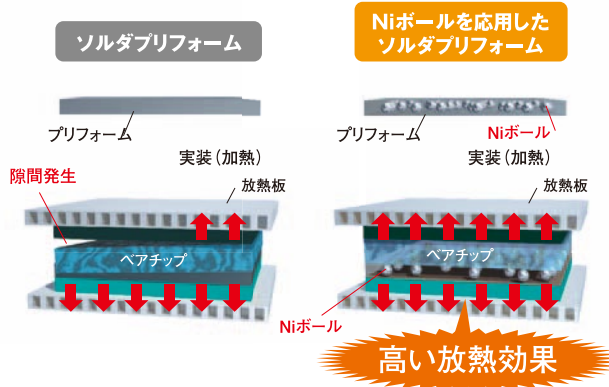
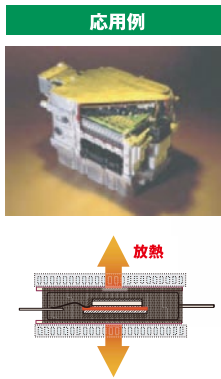
特長

- プリフォームに均一形状・サイズのNiボールを配し、ペアチップを水平に。
- 放熱効果の高い実装を可能。

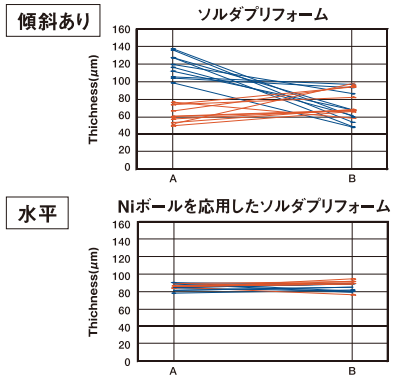
※はんだの組成についてはお問い合わせ下さい

製品仕様

□ 高い放熱効果



□ 接続部2箇所の膜厚比較



ECO SOLDER® PASTE

Cuボール含有ソルダペースト

特長

- 放熱性の高い実装を可能。
- 部品を水平に保ち、一定のクリアランスを確保。
- 用途／パワートランジスタ内部接続用など。

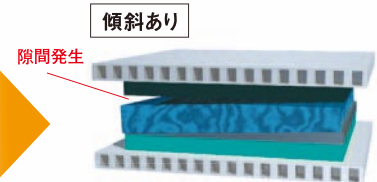
※はんだの組成についてはお問い合わせ下さい

製品仕様

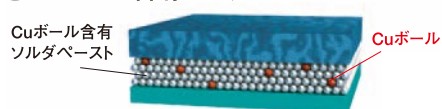
□ スペーサー用途模式図ペアチップ版（従来品との比較）

リフロー時はんだのみ溶融しCuボールは残ります。部品を水平に保ち、一定のクリアランスを確保します。結果、放熱性の高い実装を可能にします。

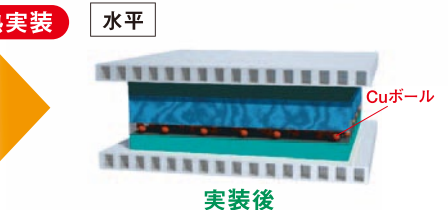
● 従来品



● Cuボール含有ソルダペースト



リフロー・放熱実装



ペースト印刷搭載時

実装後